

4971 **メック**

前田 和夫 (マエダ カズオ)

メック株式会社社長

中国関連で計画が若干未達ながら通期予想は据え置き

◆平成 28 年 3 月期第 2 四半期業績

売上高は前年同期比 1.0%減の 44 億 54 百万円となり、期初予想の 46 億 60 百万円に対して 95.6%の進捗にとどまった。薬品が売上高全体に占める割合は 3.8 ポイント上昇して 96.4%となり、海外売上高比率も 3.1 ポイント上昇の 54.6%となった。営業利益は 6.2%減の 9 億 89 百万円で、期初予想の 93.3%であった。経常利益は 91.6%、純利益は 91.3%の達成率となった。前年同期比では、経常利益は 7.8%減の 10 億 7 百万円、純利益は 1.2%減の 7 億 3 百万円である。

薬品のうち、もっとも不調だったのがディスプレイ関連であり、特に小型パネル向け薬品が予想を大きく下回った。CZ は、IoT・クラウドに使われるサーバーが伸びているが、スマートフォンやタブレット PC については伸びが鈍化している。これは、特に中国を中心として調整段階になっているためである。これにより CZ の売上高は、前年同期の 21 億 93 百万円が 22 億 70 百万円となり、薬品売上高に占める割合は、前年同期の 52.6%から 52.9%に上昇した。薬品売上高が増加しているのに営業利益が減少したのは、主に人件費が原因である。当社は現在 47 期で、創業当時に雇った人間が退職を迎える時期にさしかかっており、若い人を採用しているため人が重なっている状況にある。

為替の影響は、売上高で 2 億 44 百万円増、営業利益で 50 百万円増の効果があった。薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の比率は、前年同期の 72.2%から 74.6%に上昇する。薬品以外の売上高は、機械が 22 百万円増の 68 百万円、資材は、与信リスクがあるわりには利益を生まないため意識的に減らしており、1 億 91 百万円減の 83 百万円となった。

売上総利益は、前年同期比で 37 百万円(1.3%)の増益であった。粗利率が 64.7%から 66.2%へ上昇しているのは、薬品の売上増によるものである。販管費は 1 億 2 百万円増加した。純利益は 7 億 3 百万円で、前年同期には台湾の留保金に対する税制改正があり、過年度も含めて税額が多かったが、今期はそれがなかったために法人税の割合が低くなった。

貸借対照表では、流動資産の現金及び預金が、主に利益増加により 57 億 33 百万円に増加した。有形固定資産のうち、土地は為替差により若干増加した。建設仮勘定と無形固定資産は、基幹システムの機器およびソフトウェアが増加したために金額が増えている。投資有価証券は、保有株式の時価下落によって減少した。負債の部では、消費税等の納税で未払金が減少し、未払法人税が納税で減少した。

連結社員数が増えているのは、本体での増加に加え、現地での対応の増加に伴い、人件費の安い現地子会社での人員を増やしているためである。設備投資は現時点では金額が少ない。減価償却費は半期で 1 億 69 百万円、研究開発費は 4 億 24 百万円で、今までと同じ傾向である。研究開発費の対売上高比率は 9.5%である。

第 1～第 2 四半期の比較については、売上高が第 2 四半期に伸びて、営業利益は連結でやや下がり単体で増加した。経常利益は、為替影響があるため営業利益に比べて減少幅が大きくなった。純利益は経常利益と同じ傾向となった。品種別では薬品の割合が増加傾向で、銅表面処理剤が圧倒的になっている。CZ や V ボンドを中心と

する密着向上剤と EXE を中心とするエッチング剤は、同じような比率で推移している。CZ は、今まで伸びてきたので今期は懸念していたが、横ばいで推移した。地域別では、日本が健闘し、アジアは若干の伸び、欧州は第 1 四半期より減少した。

◆下期の見通し

台湾が若干計画未達となったが、通期予想は据え置いている。これは、下期には CZ が自動車向けに採用が進み、CZ のパッケージはサーバー向けが増えると思われるためである。EXE は、大型ディスプレイが動き出せば好転する。また EXE は、スマートフォンの HDI やフレキ用に採用してもらうように活動してきたが、その成果が上がってきている。これは、コンパクトにして消費電力を低くすると同時に、より正確で微細なものを作る動きが加速しているためである。HDI は、かなり立ち上げに向けて進んでいる会社があり、これが本格化すれば大きな量が見込める。アマルファは、アルミ筐体ですでに採用されているが、顧客のモバイル端末の売れ行きがよくないため増えていない。またステンレススチールが筐体メーカーに採用される見込みであり、まもなくステンレスのスマートフォンが出現すると思われ、その場合には、この処理にもアマルファが使用される。ステンレススチールは、アルミと意匠が異なるだけでなく、きわめて丈夫である。その分重たいが、薄く作ることで軽量化する。

◆今後の事業展開

当社のコア技術は、配線を形成すること、表面を粗化して密着性を向上させること、および金属を選択的にエッチングすることである。当社が活躍できる分野は、電気に関わるすべてであるが、特にロボットやスパコン、サーバー等は今後さらにコンパクトになり拡大する可能性が高い。ウェアラブルは、制御するスマートフォンの機能向上が図られており、2025 年に向けて指数関数的に立ち上がっていくと思われる。特に眼鏡式は視覚障害者が網膜に画像を作れるようにする技術も開発されており大きな可能性がある。カーナビや液晶テレビはスマートフォンに吸収されていこう。自動車での用途も拡大しており、医療機器にも大きな可能性がある。このような動向に合わせて、当社も準備を進めている。

パッケージ基板のロードマップとしては、CZ からフラット処理への動きは確実に進んでいる。シンプルで使いやすく実績があるという意味で CZ も引き続き重要である。高密度実装ロードマップとしては、最終的には 3D であるが、技術的に難しいため中間的な有機インターポザーを使って高密度化する方法が採用されつつある。これにはフラット処理が必要となるので、当社にとって大きなチャンスであると考えている。当社は、密着性がよく、後からドライフィルムをはがしやすい薬品である STZ を開発した。この製品は、今後難しい基板を作る場合に有益になると思う。EXE も進化しており、多くの顧客から良い反応をもらっている。

今後の足がかりとしては、高速伝送対応と金属筐体の 2 つがある。高速伝送対応としては、フラットボン드가非常に重要になってくるため、当社では戦略的にこの部分の開発に注力しており、採用も少しずつ進んでいる状況である。金属筐体については、アマルファが、小さい金額ではあるが産業用ロボットで実績があり、これを足がかりに最終的には自動車の軽量化という大きな問題の解決に役立てたいと考えている。フラットボンドは、スパコンや基地局用のマザーボードに採用が決まっている。

5G は 2010 年と比べて通信速度は 100 倍、通信容量は 1000 倍であり、そのためのインフラが必要となる。自動運転については、経済産業省が 2025 年までに完成させると宣言しており、そのために何が課題であるかを今年中にまとめるように大臣が事務方に指示を出している。このような状況に呼応して、当社としても、事業拡大に向けて、グローバル展開、新製品の開発力、およびトータルな品質保証体制を強化していく。

◆ 質 疑 応 答 ◆

CZとEXEの下期の動向について伺いたい。

足元は良好な手応えを感じている。CZは、新しく採用になった部分が立ち上がってくる。EXEは、従来の大型ディスプレイ向け以外のHDI基板で拡大が進んでおり、顧客は急いでいるようなので、来期には急速に立ち上がるかもしれない。アマルファでは、アルミ筐体だけでなく、ステンレススチール筐体にも使われる予定であり、また顧客に防水性や工程簡略化のメリットを感じてもらえば伸びる可能性がある。

EXEは線幅が混在していると対応が難しいのではないか。

EXEは普通のエッチングであり、顧客がそのドライフィルムを最適化してもらえば解決できる問題である。従来は、そこまで顧客を動かすモチベーションがなかったが、最近では、手間をかけずにきれいに正確に配線パターンを作りたいという顧客のニーズが上がっており、当社も薬品に改良を加えているため、顧客の協力があれば実現可能である。

競合関係について伺いたい。

競合他社がないわけではない。粗化して接合するだけであれば似たような製品を出している会社はあるが、接着する力や実績の点で当社とは歴然とした差がある。特にCZでは、当社はパッケージ基板で圧倒的な強さを持っている。他の薬品については、あっても2~3社程度である。EXEについては、実質的に1社しかない。その他の表面処理剤は3社程度である。どのメーカーもメッキが本業であり、専業でこの分野をやっているメーカーはない。

(平成27年11月4日・東京)

* 当日の説明会資料は以下のHPアドレスから見ることができます。

<http://www.mec-co.com/ir/library/>